

0.4mm사각의 IC Mu chip를 비접촉으로 Chucking,반송하는

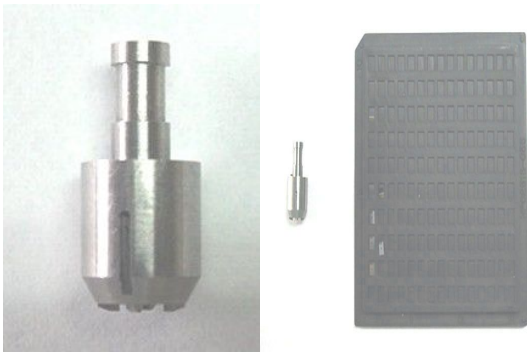
## Mu( $\mu$ )-Chip 비접촉 반송장치

당사는 0.4 mm각의 초미소 사이즈의 IC chip(mu-chip)을 비접촉에서 Pick-up, 반송하는 「Mu( $\mu$ )-chip 비접촉 반송 장치」을 개발했다. Mu chip은 전자기기의 소형화, 정지화에 따라 IC chip도 미세화해 왔다.

IC태그에도 이용되어 공장이나 창고의 생산·물류 관리, 이벤트의 입장권, 판매점에 있어서 상품 관리, 서적, 시큐리티용으로써 순조롭게 적용해 오고 있다.

### ◎ 뮤 칩 비접촉 반송 장치

「Mu chip 비접촉 반송 장치」은, 기체를 분출하는 것으로써 Mu chip과 chuck 저면에 마련한 쿠션 실내부와 팁에 대항하는 작동면과의 틈(간격)에 부압 및 정압을 발생시켜 Mu chip을 비접촉 상태에서 흡인해 현수 보관 유지한다. Chip 흡인시, 작동면과 팁과의 틈(간격)이 미소하기 때문에 작동면과 chip을 평행에 유지하는 것은 조작상 어렵기 때문에, 본기는, 미소한 쿠션실에서 효율적으로 부압이 발생하도록 기체 분출 노즐이 형성되고 있다.



### ◎ 특징

1. 0.4 mm각 팁을 비접촉에서 Pick-up 가능
2. 다이싱 한 웨이퍼 칩을 비접촉에서 반송한다.
3. 트레이의 chip을 비접촉에서 pick-up 가능.
4. 비접촉 보관 유지하고 있는 Chip의 반전, 경사에서 사용 가능.

### ◎ 적용

1. 태그 매입 IC Chip
2. 이벤트 인원 관리 태그 IC Chip
3. 미세 웨이퍼 Chip
4. 미소 렌즈
5. 미소 광학 기기

Contact : [www.zonetech.co.kr](http://www.zonetech.co.kr) ,[support@zonetech.co.kr](mailto:support@zonetech.co.kr)/tel:031-303-5858